

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-062

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、技术创新、股东回报、投资者沟通及公司治理等方面制定了“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主营业务，提质增效重发展

公司是集研发设计和生产制造于一体的半导体、产品集成企业。公司的半导体业务采用 IDM（Integrated Device Manufacturer）垂直整合制造模式，产品广泛应用于全球各类电子设计，丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD 保护器件、MOSFET 器件、氮化镓场效应晶体管（GaN FET）、碳化硅（SiC）二极管与 MOSFET、绝缘栅双极晶体管（IGBT）以及模拟 IC 和逻辑 IC。公司产品集成业务采用 ODM（Original Design Manufacturer）原始设计制造模式，是全球领先的电子产品集成企业，主要从事各类电子产品的研发设计和生产制造，业务涵盖手机、平板、笔电、IoT、家电、汽车电子等众多领域。

（一）产品集成业务

公司凭借卓越的业务开拓能力，成功拓展各细分领域的行业内主要的头部品牌，成为海内外行业头部品牌的首选合作伙伴。2024 年公司继续深耕客户价值体系，与各细分领域龙头客户保持长期深入合作关系，积极开拓韩国客户、北美客户新项目及家电、汽车等客户项目，推动合作项目“从一到多”，合作范围“更深更广”。目前，北美客户、韩国客户已成为公司产品集成业务前两大客户。公司客

户结构与产品结构优化，业务运营“提质”，同时公司积极推动降本控费，优化运营效率，内部管理“增效”。

（1）手机平板方面，2024年第二季度，韩国客户产品市场需求增加，公司作为韩国客户核心 ODM 供应商，共享市场增量空间，双方合作的新项目顺利上量，为公司奠定了稳固的业务基础。受综合毛利率较低、部分原材料涨价以及工厂人力成本上升等因素影响，导致上半年产品集成业务业绩变动。面对这种情况，公司多措并举，在实施降本增效的同时，积极与客户针对产品价格展开沟通协商，将在第三季度开始执行主要涨价措施，随着后续相关项目实现量价齐升，有望进一步提升盈利能力。

（2）笔电方面，公司是北美客户笔电整机制造的重要供应商之一，由公司配合客户生产的相关 AI PC 已经在 2024 年初开始在全球销售。2024 年，公司进一步加强与海外特定客户的研发和产能配套，第三代芯片笔电产品项目在第二季度快速上量，同时新一代项目正在合作推进。目前，公司与客户积极沟通商务条款，同时采取各种降本增效措施，第三季度，随着产品价格优化调整的具体执行，项目盈利能力将实现进一步改善。

（3）汽车电子方面，公司已积极拓展头部国内新能源汽车客户、Tier1 客户等，紧跟汽车智能化、电动化、自动化、网联化的发展要求，重点发力车载屏幕（二排电动翻转屏总成、扶手屏控制器等）、车联网系统（远程通讯控制器 T-BOX 等）的相关产品和解决方案，并为飞机供应屏幕产品，推出满足客户需求的优质产品，不断提升客户满意度和市场认可度。公司在汽车电子领域持续拓展业务广度，已实现规模化营收，并为公司带来盈利增长点，持续推动公司车载业务高质量发展。

（4）家电方面，继成功开拓全球小家电巨头客户之后，公司积极把握客户需求，发挥研发创新优势，进一步提升国际化智能制造水平，以吹风机细分领域作为突破口，成功从单一项目向多个项目拓展，目前已有多个项目顺利落地开展，并在第二季度实现增量并盈利。

（二）半导体业务

(1) 在原有产品线业务方面，公司持续发挥行业龙头优势，紧扣提升效率的目标，主要从预算控制、成本分析、流程优化等方面认真梳理和落实降本增效的重要措施，推动毛利率改善，恢复半导体业务利润增长。从 2024 年第二季度来看，受部分市场需求回暖及公司降本增效等因素影响，半导体业务收入及综合毛利率相较于 2024 年第一季度环比改善，盈利能力提升。

公司凭借产品车规优势，积极巩固海外市场份额，并不断提升国内新能源客户市场份额。公司产品在电动汽车上广泛应用在驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统等体系。汽油车时代，全球汽车单车平均应用公司芯片约 400 颗，在当前的电动车已有客户的案例中，单车最高应用接近 1,000 颗。在当前已有客户案例中，国内某前三的新能源汽车品牌单车 ASP 超过 50 美金。随着电动化智能化的趋势以及产品料号的持续扩充，未来仍有增长空间。

(2) 对于新产品与新技术领域，公司坚持创新驱动，持续投入研发，提升产品 ASP，推动半导体业务高质量可持续发展。公司在现有产品进行迭代升级推出新产品的的基础上，持续开发高功率分立器件（IGBT、SiC 和 GaN）和模块、模拟 IC 组合、功率管理 IC 和信号调节 IC 等新产品，以满足市场对高性能、高功率产品日益增长的需求，以高 ASP 产品为未来业务增长持续提供驱动力。

公司的半导体业务将投资 2 亿美元在海外研发和生产 SiC 和 GaN，以及增强工厂生产基础设施与自动化水平，加强电气化与数字化领域关键技术，支持数据中心、可再生能源与新能源汽车等领域的高功率应用，为公司带来新的增长空间。公司半导体业务将继续紧跟全球半导体创新发展的趋势，加快优化存量能力，继续拓展创新边界，进一步提升生产经营效率。

二、重视股东回报，维护投资者权益价值

公司始终高度重视投资者回报，着眼于长远和可持续发展的目标，严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，在综合考虑股东权益、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等的基础上，制定并执行分红方案，对公司利润分配做出合理安排。

经公司 2023 年度股东大会审议通过，2023 年度权益分派方案为：向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。2023 年公司实施回购计划，实际回购公司股份 4,362,400 股，占公司总股本的 0.35%，使用资金总额 19,997.90 万元（不含交易费用）。公司 2023 年年度利润分配方案现金分红总额预计约 3.55 亿元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.03%。

公司将全力夯实经营管理，继续秉承积极回报投资者的发展理念，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。

三、传递公司价值，加强投资者沟通交流

公司始终高度重视投资者关系管理工作，积极采取召开业绩说明会、参加湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日、召开股东大会、线下线上交流、接听投资者关系热线电话、邮箱及网络平台互动等综合化措施，加强与投资者之间的沟通交流，并拓展图片、表格、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，使投资者更加直观、便捷地理解公司经营情况。

公司将持续推动投资者关系工作多样化，提升研究分析水平，继续丰富与各类投资者沟通交流渠道，建立多层次投资者互动和交流机制，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效。

四、坚持规范运作，持续提升公司治理水平

（一）完善规章制度，提高治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，从全体股东利益出发，不断提高公司治理水平，设置了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，其中，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略及投资委员会，形成了权责明确、运作规范、透明高效的运营决策机制，保障了董事会的科学运行、规范运作。2024 年，公司按照独立董事制度政策变化及监管要求，修订了《独立董事制度》及董事会专门委员会的相关议事规则。

（二）践行 ESG 理念，坚持可持续发展道路

公司已制定绿色能源机制，包括企业购电协议(PPAs)、能源属性证书(EACs)、

绿色电价、安装光伏发电设备等定制解决方案，有效降低外购电力产生的温室气体排放。高度重视水资源消耗对环境的影响，通过“中水回用”、“过滤水回用”、“空调系统冷却用水改善”等项目开展替代水源实践，完成各业务板块制定的节水目标。

此外，公司积极推进新型清洁技术的创新研发与应用。产品集成业务板块通过将部分生产流程中的模切硅胶套代替开模硅胶套，制程简单良率高、密封效果好、成本优异、一致性好、不用重复开模具节省能源的消耗；在卡托塑胶部分使用可再生材料从而达到产品配件可循环再生目的；减少部分对于消费电子产品主板空贴位置的锡膏处理，减少对环境有害物质的使用。半导体业务板块研发采用的宽带隙材料，较硅类材料，可显著节能并减少二氧化碳排放。

公司始终致力于成为一家具有全球社会责任感的公司，积极响应中国在 2030 碳达峰、2060 碳中和等一系列应对气候变化的中长期目标和规划。

（三）人才培养和激励

公司不断优化人才激励机制，建立健全优秀人才长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，稳定及优化科研队伍，提高公司员工的凝聚力，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期健康发展。

五、其他说明

本公告所涉及的公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受外部经济环境、行业市场环境、政策法规等因素变化的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日